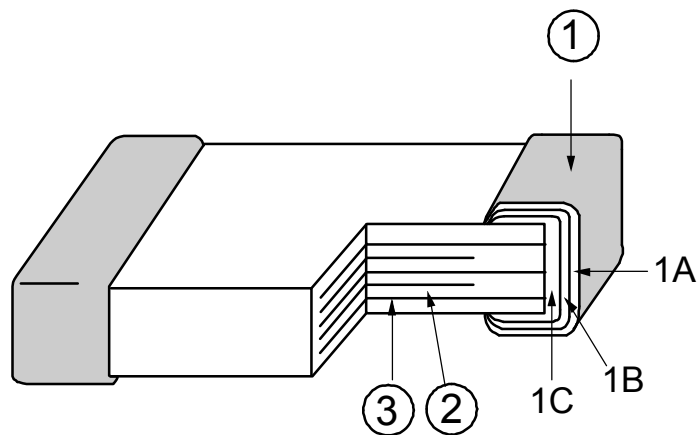


ボンディング対応チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表
 Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor Bonding Type

<GMD series>



| No. | 名称/Name | 主原料/Material |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 1 | 外部電極 Termination | |
| | 1A めっき層 Plated layer | 金 Gold |
| | 1B めっき層 Plated layer | ニッケル Nickel |
| | 1C 下地電極 Electrode | 銅 Copper |
| 2 | 誘電体素子 Dielectric layer | チタン酸バリウム系 Ceramic |
| 3 | 内部電極 Inner electrode | ニッケル Nickel |